

华泰联合证券有限责任公司
关于沐曦集成电路（上海）股份有限公司
2025 年度持续督导跟踪报告

保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司	被保荐公司简称：沐曦股份
保荐代表人姓名：邹棉文	联系电话：010-56839300
保荐代表人姓名：孙琪	联系电话：010-56839300

根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”或“保荐人”）作为沐曦集成电路（上海）股份有限公司（以下简称“沐曦股份”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票保荐机构，对沐曦股份进行持续督导，并出具本持续督导跟踪报告：

一、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

无。

二、重大风险事项

由于沐曦股份尚未实现首次盈利，保荐机构特别提示投资人关注如下重大风险：

（一）公司尚未盈利的风险

报告期内，公司归属于母公司股东的净利润、归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为-78,944.63万元、-82,970.05万元，均为负值。截至2025年12月31日，公司经审计的母公司报表未分配利润为-154,888.26万元，母公司报表可供股东分配的利润为负值。

公司所处GPU芯片行业作为典型资本与技术双密集型领域，公司为突破国际生态垄断并实现自主可控目标，始终坚持自主创新，持续加大核心技术攻坚力度，报告期内公司研发费用为102,739.29万元，占营业收入比例为62.49%。公司产品具备良好的市场前景和广阔的市场空间，营收增速预计保持高位，未来随着公司持续进行成本优化及费用控制，毛利率和期间费用率将趋于稳定，新产品的放量销售将持续为公司带来业绩贡献，公司亏损有望持续收窄，实现扭亏为盈。

公司存在上述尚未盈利的风险，且已在沐曦集成电路（上海）股份有限公司2025年年度报告中“重要提示”及“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”中充分披露。

（二）其他重大风险事项

1、业绩大幅下滑或亏损的风险

公司本年度营业收入大幅增长，净利润实现亏损收窄，不存在业绩大幅下滑的情形，公司亏损的风险请详见本节“（一）公司尚未盈利的风险”。

2、核心竞争力风险

公司所处GPU行业为横跨集成电路和人工智能两大典型的技术密集行业，核心技术与知识产权是公司最重要的无形资产，对于公司保持和提升核心竞争力尤为关键。公司自主研发的GPU IP已历经了多次迭代升级，应用于人工智能训练和推理、高性能计算的GPU产品已规模化量产，软件生态的丰富度、兼容性与稳定性不断提高，产品综合性能达到国内领先水平。但随着人工智能应用的快速普及，对于AI芯片的需求不断扩增，吸引越来越多的行业参与者，市场竞争日趋激烈。此外，如果产品迭代和技术创新无法满足市场需求，公司将可能面临主要产品销售不及预期、毛利率持续下滑、长期无法实现盈利等风险。未来，公司将紧跟行业发展趋势，通过持续的技术创新、产品迭代和开源建设，保持技术先进性和市场影响力。

3、经营风险

(1) 公司持续稳定经营和未来发展存在不确定性的风险

公司通过持续高强度、高水平的研发投入形成技术领先优势，并逐渐将研发优势转换为产品优势，已量产的产品线覆盖了人工智能训练及推理、通用计算（包括科学计算）等计算场景。核心产品快速商业化落地，市场认可度、影响力不断提升。公司目前处于快速发展阶段，业务规模不断扩大，为保持技术先进性和市场竞争力，公司将继续进行较大金额的研发投入以及其他必要的经营相关资金支出，此外，公司产品进入重点行业客户需经历严苛的技术验证及生态适配周期。因市场景气度、行业竞争、客户拓展、供应链管理等影响经营结果的因素较为复杂，公司的营业收入增速可能不及预期，存在未来一段时期内持续亏损的风险。为应对该风险，公司将紧跟行业发展趋势，通过持续的技术创新、产品迭代和开源建设，保持技术先进性和市场影响力，并围绕教科研、金融、交通、能源、医疗健康、大文娱等重点行业，加速GPU产品在垂直应用场景的商业化落地，推动人工智能赋能千行百业。

(2) 供应链安全风险

公司采用Fabless经营模式，主要负责芯片的研发、设计与销售，生产环节由专业的外协厂商完成，主要包括晶圆代工厂和封装测试厂，报告期内公司与部分境外供应商进行合作；此外，公司在重要物料HBM以及芯片研发设计所需的EDA工具和部分接口IP等方面的采购，也涉及主要终端供应商来自于境外的情况。在中美科技博弈持续升级的背景下，因美国政府相关政策影响，公司目前在先进制程晶圆代工和HBM供应等方面受到不利限制。由于集成电路领域专业化分工的产业结构及较高的技术门槛，其中部分供应商的产品或服务具有稀缺性和独占性，较难在短时间内形成同质量的国产替代。如果未来公司与相关供应商的合作关系发生恶化、中断等情形，或者由于其他不可抗力因素而无法继续进行合作，若公司未能及时落实高质量的国产替代解决方案，则将对公司生产经营的可持续性构成不利影响。为应对上述风险，公司基于对国际政策形势的研判，较早启动国产供应链布局、提早规划并设计了基于国产供应链的产品，确保产品高质量及可持续的供应与交付。随着市场影响力和产业链资源逐渐提升，公司将持续培育国产

供应商，进一步推动关键供应环节的国产配套，全面提升国内集成电路产业链的竞争力。

4、财务风险

(1) 持续亏损和存在累计未弥补亏损的风险

公司报告期内尚未实现盈利，主要系：1) 中国GPU芯片市场曾长期被国外巨头垄断，国产GPU芯片渗透率低，面临技术标准适配及用户习惯迁移障碍，市场拓展呈渐进式发展，且国产GPU芯片厂商整体起步较晚，处于技术突破和产品落地初期，在多方面有待提升，需投入大量资源用于研发、市场拓展和生态建设，导致成本居高不下；2) 公司智算推理GPU芯片曦思N100系列、训推一体GPU芯片曦云C500系列分别于2023年4月和2024年2月正式量产，因公司产品进入重点行业客户需经历严苛的技术验证及生态适配周期，公司销售规模处于快速爬坡阶段，目前收入规模仍然难以覆盖成本费用支出；3) 公司所处GPU芯片行业属资本与技术双密集型，有极高技术壁垒与密集研发投入特点，公司为夯实产品竞争优势持续加大研发投入；4) 公司因实施股权激励而确认了较大金额的股份支付费用。

因市场景气度、行业竞争、客户拓展、供应链管理等影响经营结果的因素较为复杂，公司的营业收入可能无法按预期增长，存在未来一段时期内持续亏损的风险。

(2) 经营活动现金流持续为负的风险

本报告期公司经营活动产生的现金流量净额为-126,007.18万元，现金流持续为负主要系以下原因共同导致：1) 报告期内公司尚未实现盈利，收入规模无法覆盖各项成本费用支出；2) 客户回款时间相比公司收入确认时间有所滞后，应收账款余额较大；3) 受地缘政治形势影响，为保障原材料供应稳定，公司在报告期积极进行战略备货，期末存货余额大幅增加。

公司目前处于快速发展阶段，业务规模不断扩大，为保持技术先进性和市场竞争力，公司将继续进行较大金额的研发投入以及其他必要的经营相关资金支出，因此存在未来一段时间内公司经营活动现金流持续为负的可能性。若公司无法通

过股权融资或债权融资等方式合理筹措资金，有效改善现金流，则在营运资金周转方面将会面临一定风险。

（3）应收账款回收风险

本报告期末，公司应收账款账面价值为72,572.47万元，占期末流动资产的比例为5.74%，占同期营业收入的比例为44.14%。截至本报告公告之日，部分大额应收账款客户尚未完成全部回款，如该等客户财务状况恶化或付款进度不及预期，则相关应收账款可能面临无法全部收回的风险。本报告期末，公司应收账款有所增加，主要系公司核心GPU产品持续出货，营业收入增长幅度较大，应收账款金额随营业收入规模的增加而增加。随着公司业务规模的扩大，应收账款可能继续增加，若下游客户财务状况出现恶化，可能存在应收账款无法回收的风险，进而对公司未来业绩造成不利影响。

（4）预付款资金安全风险

本报告期末，公司预付账款余额为83,427.99万元，占公司流动资产的比例为6.60%，金额较大。报告期内随着公司业务规模快速增长，原材料采购需求相应增加；受行业惯例、采购周期、国际形势等因素影响，为保障未来产品供应，公司向晶圆、HBM等重要原材料供应商进行提前订货并预付较高比例的货款，导致预付账款规模较大。如果该等预付款对应物料后续无法顺利交付或交付时间进一步推迟，公司将面临流动资金占用和资金安全的风险。

（5）存货周转及跌价风险

本报告期末，公司存货账面价值为149,609.34万元，占流动资产的比例为11.83%。主要系基于供应商的生产周期及其他不确定性因素，公司为保障向下游客户按时交付产品，相应增加了存货储备。如果未来公司不能有效拓宽销售渠道、优化库存管理，导致出现大规模的存货积压情形，则可能对公司营运资金周转造成不利影响；若进一步发生市场情况变化导致存货无法顺利销售，将产生存货跌价风险，影响公司经营业绩。

（6）募投项目新增较大费用支出的风险

募集资金投资项目实施过程中，将产生较大金额的折旧摊销和其他费用支出，

对公司经营业绩有直接影响。由于募投项目的建设、完工及产生效益需要一定的时间周期并且可能存在各种不确定性,若未来公司所处市场环境等因素发生重大不利变化,导致募投项目无法实现预计效益,则前述新增的折旧摊销、期间费用等将对公司未来经营业绩构成较大不利影响。

5、行业风险

随着人工智能应用的快速普及,对于AI芯片的需求不断扩增,吸引越来越多的行业参与者,市场竞争日趋激烈。从全球范围来看,经过多年发展,已经基本形成了由英伟达和AMD组成的“一超一强”寡头垄断格局,两家企业在综合技术实力、销售规模、资金实力、人员数量等各方面优势明显;国内市场方面,受益于中美科技博弈和国产替代政策推动,近年来我国本土品牌AI芯片的市场渗透率已呈显著上升趋势,但总体上仍处于发展相对初期阶段,尚未形成较明朗的竞争格局。同时,随着AI芯片领域国产替代进程的不断加速,未来可能将有更多国内厂商进入到该市场参与竞争。为应对上述风险,公司将坚持以自主技术创新为导向,持续深耕GPU行业通过技术创新和设计优化,持续提升GPU架构的通用性、GPU产品的高能效与GPU软件生态的易用性,紧跟行业前沿技术发展趋势,通过技术升级和产品迭代,不断扩大竞争优势、巩固市场地位,推动国产算力产业链自主可控。

三、重大违规事项

无。

四、主要财务指标的变动原因及合理性

2025年度,公司主要财务数据、财务指标及其变动情况如下:

单位:万元

主要财务数据	2025 年度/2025 年末	2024 年度/2024 年末	本期比上年同期增减 (%)
营业收入	164,408.55	74,307.16	121.26
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业	164,408.55	74,190.87	121.60

实质的收入后的营业收入			
利润总额	-77,939.27	-140,533.52	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-78,944.63	-140,887.94	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-82,970.05	-104,387.20	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-126,007.18	-214,802.33	不适用
归属于上市公司股东的净资产	1,316,547.08	117,830.41	1,017.32
总资产	1,367,487.76	388,958.25	251.58
主要财务指标	2025 年	2024 年	本期比上年同期增减 (%)
基本每股收益 (元/股)	-2.44	-7.01	不适用
稀释每股收益 (元/股)	-2.44	-6.66	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	-2.57	-5.19	不适用
加权平均净资产收益率 (%)	-9.61	-99.70	增加 90.09 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-10.11	-73.87	增加 63.76 个百分点
研发投入占营业收入的比例 (%)	62.49	121.24	减少 58.75 个百分点

上述主要财务数据及财务指标的变动原因如下：

1、本期营业收入较上年同期增加90,101.39万元，同比增长121.26%，主要系报告期内随着公司产品及服务获得下游客户的广泛认可与持续采购，公司GPU产品出货量显著增长，带动收入规模较上年同期实现显著增加。

2、利润总额同比亏损收窄62,594.26 万元，较上年同期亏损收窄44.54%，归属于上市公司股东的净利润同比亏损收窄61,943.31 万元，较上年同期亏损收窄43.97%，主要系报告期内营业收入较上年同期大幅增长，以及公司股份支付费用较上年同期有所减少，上述因素对公司利润产生正向影响，降低公司亏损幅度，使得公司经营业绩呈现减亏向好的发展态势。

3、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加88,795.15万元，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金大幅增加所致。

4、归属于上市公司股东的净资产同比增加1,198,716.67 万元，总资产增加978,529.52 万元，主要系报告期内公司融资所致。

5、基本每股收益同比亏损收窄4.57元/股、稀释每股收益同比亏损收窄4.22元/股，主要系归属于上市公司股东的净利润较上年同期亏损收窄所致。

6、加权平均净资产收益率较上年同期增加90.09个百分点，主要系归属于上市公司股东的净利润较上年同期亏损收窄所致。

7、研发投入占营业收入的比例为62.49%，较上年同期减少58.75个百分点，主要系公司本期营业收入较上年同期大幅增长所致。

五、核心竞争力的变化情况

公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面：

（一）技术优势：技术积累深厚全面，核心技术自主可控

GPU芯片设计复杂，其核心技术此前仅掌握在几家国际领先企业手中。公司是国内少数几家全面系统掌握了GPU架构、GPU IP、先进制程GPU芯片及其基础系统软件研发、设计和量产等全流程核心技术的企业之一，拥有自主研发的GPU IP、GPU指令集和架构等，充分掌握并构建了一整套完善且自主可控的底层核心技术体系。公司在长期自主研发和产业化过程中积淀了丰厚的核心技术，建立了完善的研发体系，形成了一系列具有自主知识产权的核心技术成果。截至2025年12月31日，公司拥有境内发明专利350项、集成电路布图设计专有权4项、软件著作权41项，并多次与政府合作科研项目，技术储备位居国内GPU行业第一梯队。

（二）通用性优势：以GPU架构和GPU IP打造全系列GPU产品，具备通用性、灵活性和自主性

公司全系列产品采用统一的GPU计算架构，兼具通用性和高性能。由于以大模型为特征的通用人工智能技术不断演进，例如算法和模型持续迭代、数据的规模和质量持续升级，其所要求的建模仿真的精度和计算效率大幅提升，导致人工

智能产业计算复杂度持续提升。同时，目前绝大部分大模型厂商的算法创新均基于GPU实现，而公司通用、灵活的GPU架构能够高效适应云端快速迭代的复杂算法和大量非传统模型结构，从而支持更为广泛的人工智能应用场景。

GPU IP与指令集方面，公司是国内少数坚持自主研发核心GPU IP的集成电路设计企业，经过多年产品设计及落地经验的积累，已形成了全面覆盖计算（人工智能训练、推理、通用计算）和渲染场景的核心GPU IP，打造了由超过600条（XCORE1.0计算GPU）、800条（XCORE2.0渲染GPU）指令组成自主安全可控的MXMACA指令集。自研核心GPU IP具有灵活性和自主性优势，能够通过GPU IP的设计优化摆脱对最先进工艺的依赖、弥补工艺代差带来的性能损失。公司自主研发的核心GPU IP不仅满足了当前复杂多样的计算需求，还为未来的技术创新和产品迭代奠定了坚实的基础。

（三）高能效优势：GPU硬件设计在多个维度突破国外垄断

根据多家行业权威的国家实验室、计算中心、研究所的测试结果，公司GPU产品在单卡性能、集群性能及稳定性等多维度方面具有领先的产品表现力，具体体现如下：

公司训推一体GPU具备国内领先的计算能力，拥有丰富的标量、矢量和张量计算单元，全面支持各种主流精度的计算加速，能够满足人工智能训练和推理、通用计算、科学计算等多元化的算力需求，大幅提升了智算集群的多场景融合应用能力。同时，公司是全球少数几家掌握了复杂多级缓存结构的GPU企业，凭借独特的缓存组网技术，能够针对不同场景灵活自适应多级缓存控制策略，实现对高速缓存的精细管控、有效提升缓存命中率，满足GPU高算力下对于高带宽的需求。

公司具备国内稀缺的高带宽、超多卡互连能力，在集群性能、灵活性和可扩展性方面均处于行业领先地位。随着大模型参数规模指数级增长，单卡有效算力难以应对超大规模的算力需求，高带宽、低延迟的卡间互连技术成为关键竞争要素。公司自主研发的MetaXLink高速互连技术突破了传统PCIe总线在带宽和延迟方面的限制，达到了与国际主流旗舰产品相当的互连带宽性能。同时，公司的GPU产品可实现2-128卡等多种互连拓扑及超节点架构，满足从中小型训练到超

大规模集群的差异化需求，为构建高密度算力和大规模集群、处理更为复杂的人工智能任务提供了关键技术支撑。

当前人工智能训练任务呈现超线性、高故障率特征和异构混训趋势。公司在算力、互连通信、软件生态等方面实现了有效均衡，GPU产品在实际智算集群运营中发挥了强大的性能，能够稳定、无中断地执行海量参数模型分布式训练任务。同时，公司的GPU产品支持构建异构融合计算集群，能够在算子层隔绝异构平台差异，实现集群的弹性扩展，从而有效帮助下游客户在国产替代切换过程中充分挖掘既有资源，提供了扩展现有智算集群、提升整体算力效能的优化方案。

（四）易用性优势：“自主创新与开放兼容”双轨并行，打造了具备易用性和可扩展性的软件生态

易用性方面，公司自主研发的MXMACA软件栈为开发者提供了完整的AI开发工具链，利用自有技术完成对相关开源框架和工具的适配、编译、验证、优化等，不断降低开发者使用门槛。高性能方面，公司基于GPU软硬件协同优化技术，从软件实际需求出发，精准定义硬件的功能与性能，实现软硬件之间的深度协同与优化，充分释放GPU硬件性能潜力。

通用性方面，公司MXMACA软件栈实现了对CUDA生态的高度兼容，为人工智能、通用计算和大数据处理等领域的现有应用提供了高效迁移至MXMACA软件栈的能力，开发者无需过多修改现有代码即可将应用快速部署到公司的GPU产品上运行，大幅降低客户应用迁移本、提升迁移效率。MXMACA软件栈在AI框架、高性能算子库的支持度和模型的适配度方面具备深厚的积累，支持超过6,000个CUDA应用，与超过1,000个模型实现了原生适配，其中，Day 0适配Qwen3.5-397B-A17B、MiniMax M2.5、智谱AI GLM-5、智谱 AI GLM-OCR、阶跃星辰基座模型Step 3.5 Flash、PaddleOCR-VL-1.5、Tencent-HY-MT1.5、大晓机器人开悟世界模型 3.0等超过13个大模型。基于较强的生态兼容性，公司MXMACA软件栈能够开放拥抱全球开发者丰富的开源成果，拥有丰富的人工智能落地场景。

沐曦股份坚持推动软件生态开源共享，通过产学研合作不断助力大模型应用在千行百业加速落地。自2025年2月14日公司开源社区开放以来，截至2026年3

月13日，公司MXMACA软件栈注册用户超过30万人，网络API调用次数超过5,591万次，文件下载量超过16万次。公司是国内少数提供核心软件生态开源、提供版本SDK公开下载渠道、提供英文开发文档资料的GPU公司，MXMACA软件栈已公开500余份开发文档和手册，并已成功引入中国高校教育体系，覆盖超过半数的中国C9高校，有望打破国外软件生态垄断、支持中国人工智能产业转型升级。

（五）产业化优势：优质的产业链上下游资源，快速实现商业化落地

在“1+6+X”的战略指引下，公司坚持开放共赢，凭借领先的技术实力、长期的行业资源积淀已与产业链上下游建立了良好的合作关系，广泛适配整机服务器、操作系统、运维管理平台、主流AI框架、主流大模型等上下游生态。

凭借突出的产品性能和稳定的供应能力，截至报告期末，公司GPU产品累计销量超过55,000颗。公司深度构建“1+6+X”生态与商业布局，基础算力底座方面，公司产品相继应用部署于10余个智算集群，算力网络覆盖国家人工智能公共算力平台、运营商智算平台和商业化智算中心，区域横跨北京、上海、杭州、长沙、中国香港等地区，并逐渐向更多区域延伸。公司GPU产品深度赋能众多行业应用场景，已率先实现教科研、金融、交通、能源、医疗健康、大文娱等行业应用，并积极布局“具身智能”、“低空经济”等前沿方向，产品赋能真实应用场景的竞争力和交付能力得到充分验证。

公司构建了稳定的供应链体系，积累了丰富的供应链管理经验和动态、灵活的库存管理机制，并较早启动国产供应链布局、提早规划并设计了基于国产供应链的产品，能够确保产品高质量及可持续的供应与交付。截至报告期末，公司在晶圆生产制造、封测、存储颗粒、EDA、IP等核心环节的国产化上均已取得一定突破。随着市场影响力和产业链资源逐渐提升，公司将持续培育国产供应商，进一步推动关键供应环节的国产配套，全面提升国内集成电路产业链的竞争力。

（六）团队优势：拥有稀缺、稳定的全建制世界级技术团队

公司创始团队拥有深厚的GPU技术积累及全流程量产经验，在国际领先GPU公司负责设计并量产了多款高性能计算GPU和高性能渲染GPU，具备敏锐的市场洞察能力、前瞻性视野和国内稀缺的万卡大集群落地经验。创始人陈维良先生拥

有20年以上GPU设计及量产经验，带领团队主导并完成多款高性能GPU产品的流片和量产，曾获“上海产业菁英高层次人才-产业领军人才”、“中国信息协会常务理事”等称号或荣誉。联合创始人彭莉女士是芯片架构资深专家，曾作为主架构师完成了多款高端复杂的GPU芯片设计。联合创始人杨建博士是三维图形与高性能计算生态领域资深专家，拥有丰富的GPU芯片设计及软件生态开发经验。

公司创始团队以近二十年GPU行业的工作历程，聚合起一批扎根芯片设计、GPU和人工智能行业的资深工程师，组成了核心技术研发团队和经营管理团队，形成了一支富有远见、深刻洞察全球GPU、人工智能行业技术发展趋势，具有持续自主创新能力的技术研发团队。截至2025年12月31日，公司已在北京、南京、成都、武汉、杭州、中国香港等地建立全资子公司及研发中心，共有675名研发人员，占员工总人数的比例为73%；公司员工中有557人拥有硕士及以上学位，为公司持续的技术创新和产品研发提供了重要的人才基础。此外，公司的市场、运营等部门的核心团队均拥有行业内知名公司多年的工作经历，具有丰富的产业经验和专业的管理能力。

综上所述，2025年度，公司核心竞争力未发生不利变化。

六、研发支出变化及研发进展

（一）研发支出及变化情况

2025年度，公司研发支出及其变化情况如下：

单位：万元

项目	本年度	上年度	变化幅度（%）
费用化研发投入	102,739.29	90,089.04	14.04
资本化研发投入	-	-	/
研发投入合计	102,739.29	90,089.04	14.04
研发投入总额占营业收入比例（%）	62.49	121.24	减少 58.75 个百分点
研发投入资本化的比重（%）	-	-	/

2025年度，公司研发费用为102,739.29万元，同比上升14.04%，未发生重大变化，公司对新产品、新技术的研发持续稳定地进行投入。

（二）研发进展

随着技术不断自主创新和商业化能力日臻完善，公司已成为我国人工智能产业链的重要参与者，积极推动国家智算领域的自主可控，不断加速GPU芯片国产替代进程，参与了数个国家级和省级重大科研课题并积累了一系列知识产权和荣誉奖项。截至2025年12月31日，公司拥有境内授权专利及软件著作权共计401项，其中发明专利350项。

报告期内，公司获得的知识产权数量情况如下：

项目	本年新增		累计数量	
	申请数（个）	获得数（个）	申请数（个）	获得数（个）
发明专利	248	136	725	350
实用新型专利	0	0	8	8
外观设计专利	3	0	5	2
软件著作权	17	17	41	41
其他	/	/	/	/
合计	268	153	779	401

七、新增业务进展是否与前期信息披露一致

不适用。

八、募集资金的使用情况及是否合规

（一）募集资金基本情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间

公司首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）并在科创板上市申请已于2025年10月24日经上海证券交易所上市审核委员会审核同意，已取得中国证券监督管理委员会出具的证监许可〔2025〕2507号文同意注册，批文落款日为2025年11月12日。根据注册批文，公司获准向社会公开发行人民币普通股4,010.00万股，每股发行价格为人民币104.66元，募集资金总额为人民币419,686.60万元，扣除发行费用人民币29,755.50万元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币

389,931.10万元。

上述资金已全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2025年12月11日出具《沐曦集成电路（上海）股份有限公司验资报告》（信会师报字[2025]第ZA15251号）。公司已开立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并与账户开设银行、保荐人华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐人”）签订了募集资金监管协议。

2、本年度使用金额及年末余额

本报告期内，上述募集资金专项账户共用于募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）支出 261,407,048.76 元。截至 2025 年 12 月 31 日，累计用于募投项目支出 261,407,048.76 元，累计收到的利息及扣减手续费净额 54,591.34 元，募集资金余额为 3,918,107,316.07 元。具体明细如下：

单位：万元

项目	金额
一、募集资金总额	419,686.60
其中：超募资金金额	-
减：直接支付发行费用	29,755.50
二、募集资金净额	389,931.10
减：	
以前年度已使用金额	-
本年度使用金额（注 1）	26,140.70
暂时补流金额	-
现金管理金额	-
银行手续费支出及汇兑损益	
加：	
募集资金利息收入	5.46
其他-尚未置换及支付的发行费用（注 2）	2,041.85
其他-尚未置换的预先投入自有资金	25,973.03
三、报告期期末募集资金余额（注 3）	391,810.73

注 1：其中包括公司以自筹资金预先投入募投项目金额 25,973.03 万元，截至 2025 年 12 月 31 日公司尚未以募集资金置换。

注 2：公司尚未置换及支付的发行费用暂时存放于中信银行募集资金专户。

注 3：上述数据如有尾差系四舍五入所致。

（二）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕69号）等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、管理及使用情况的监管等方面做出了具体、明确的规定。公司分别于2025年11月、2025年12月与保荐人及招商银行股份有限公司上海自贸试验区分行营业部、宁波银行股份有限公司上海分行、上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行、中信银行股份有限公司上海陆家嘴支行签订了募集资金专户存储监管协议并在上述银行开设募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行有效监督和管理，以确保用于募投项目的建设。使用募集资金时，公司严格履行申请和审批手续，并及时通知保荐人，随时接受保荐人监督，未发生违反相关规定及协议的情况。

单位：万元

开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
招商银行股份有限公司上海自贸试验区分行营业部	121939314310000	245,755.50	使用中
宁波银行股份有限公司上海分行	86011110001953911	45,306.27	使用中
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	97160078801000006296	98,707.07	使用中
中信银行股份有限公司上海陆家嘴支行	8110201081688888888	2,041.89	使用中

注：中信银行募集资金专户余额系尚未置换及支付的发行费用及当期收到的累计利息收入。

（三）本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目资金使用情况

报告期内，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕69号）等相关法律法规、规范性文件的规定和

要求使用募集资金，公司实际使用募集资金人民币261,407,048.76元。

2、募投项目先期投入及置换情况

2025年12月30日，公司召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币25,973.03万元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金人民币564.11万元置换已支付发行费用的自筹资金，具体情况如下：

单位：万元

募集资金投资项目	拟使用募集资金投入金额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
新型高性能通用GPU研发及产业化项目	245,919.76	25,973.03	25,973.03	尚未实施	2025年12月30日
其中：第二代高性能通用GPU	84,101.70	15,880.99	15,880.99		
第三代高性能通用GPU	161,818.06	10,092.04	10,092.04		
新一代人工智能推理GPU研发及产业化项目	45,305.64	-	-	不适用	2025年12月30日
面向前沿领域及新兴应用场景的高性能GPU技术研发项目	98,705.70	-	-	不适用	2025年12月30日

截至2025年12月31日，公司预先以自筹资金投入募投项目及支付发行费用的资金尚未实施置换。

2025年12月30日，公司召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际需要，在经过相关审批程序后，预先使用自有资金支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换。截至2025年12月31日，公司尚未实施募集资金置换事项。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。

5、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购公司股份并注销的情况

公司未超募，不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购公司股份并注销的情况。

6、节余募集资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

7、募集资金使用的其他情况

由于公司首次公开发行股票并在科创板上市实际募集资金净额小于《沐曦集成电路（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中拟投入的募集资金金额，公司于 2025 年 12 月 30 日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整募投项目拟投入金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额结合实际情况调整募投项目拟投入的募集资金金额。具体调整如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	调整前拟使用募集资金投入金额	调整后拟使用募集资金投入金额
1	新型高性能通用 GPU 研发及产业化项目	340,992.38	245,919.76	245,919.76
1.1	其中：第二代高性能通用 GPU	136,977.30	84,101.70	84,101.70
1.2	第三代高性能通用 GPU	204,015.07	161,818.06	161,818.06
2	新一代人工智能推理 GPU 研发及产业化项目	57,813.35	45,305.64	45,305.64
3	面向前沿领域及新兴应用场景的高性能 GPU 技术研发项目	102,115.42	99,141.19	98,705.70
合计		500,921.15	390,366.59	389,931.10

（四）变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司募投项目未发生变更。

（五）募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募投项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

九、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

（一）控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员的持股情况

截至2025年12月31日，公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员的直接持股及其变动情况如下：

姓名/名称	职务/身份	期初持股数（股）	期末持股数（股）	股份增减变动量（股）	增减变动原因
陈维良	董事长、总经理、实际控制人	824,180	20,129,832	19,305,652	公司资本公积转增（注1）
上海骄迈企业咨询合伙企业（有限合伙）	控股股东、实际控制人一致行动人	1,960,000	47,871,181	45,911,181	公司资本公积转增（注1）
上海曦骥企业咨询合伙企业（有限合伙）	实际控制人一致行动人	596,450	14,567,737	13,971,287	公司资本公积转增（注1）
彭莉	董事、副总经理、首席技术官、核心技术人员	-	-	-	-
杨建	董事、副总经理、首席技术官、核心技术人员	-	-	-	-
陈阳	职工代表董事	-	-	-	-
王爽	董事、核心技术人员	-	-	-	-
俞博文	董事	-	-	-	-
李树华	独立董事	-	-	-	-
刘辛蕊	独立董事	-	-	-	-

姓名/名称	职务/身份	期初持股数（股）	期末持股数（股）	股份增减变动量（股）	增减变动原因
朱琴	独立董事	-	-	-	-
魏忠伟	财务负责人、董事会秘书	-	-	-	-
吴志华	核心技术人员	-	-	-	-
潘江婷	董事（离任）	-	-	-	-
汤治华	董事（离任）	-	-	-	-
杨兆国	董事（离任）	-	-	-	-

注1：2025年3月，公司以资本公积金向全体股东同比例转增，合计转增股本345,260,443股，公司注册资本由14,739,557元增加至360,000,000元。

（二）控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员的质押、冻结及减持情况

截至2025年12月31日，公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员持有的公司股份均不存在质押、冻结及减持的情形。

十、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项

无。

(本页无正文, 为《华泰联合证券有限责任公司关于沐曦集成电路(上海)股份有限公司 2025 年度持续督导跟踪报告》之签章页)

保荐代表人(签字): 邹棉文 孙琪
邹棉文 孙琪

华泰联合证券有限责任公司(公章)

2026年3月26日

